

Plaskon 7060

Ероху; Epoxide

Cookson Electronics - Semiconductor Products

Описание материалов:

This material is a reduced-stress epoxy molding compound for the encapsulation of a variety of semiconductor devices ranging from small lead count DIPs to medium lead count PLCCs and SOICs. It was especially developed for balanced end use properties.

| Главная Информация | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Полупроводникового Лазерная маркировка Хорошая производительность формования Отличный внешний вид | | |
| Формы | Жидкость | | |
| Метод обработки | Литье из смолы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.83 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.25 | % | ASTM D955 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Флекторный модуль | 1.52 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 0.0138 | MPa | ASTM D790 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура перехода стекла | 155 | °C | ASTM E1356 |
| CLTE-Поток | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопротивление громкости | 1.6E+16 | ohms-cm | ASTM D257 |
| Диэлектрическая прочность | 16 | kV/mm | ASTM D149 |
| Диэлектрическая постоянная (1 kHz) | 4.00 | | ASTM D150 |
| Коэффициент рассеивания (1 kHz) | 5.0E-3 | | ASTM D150 |
| Дуговое сопротивление | 180 | sec | ASTM D495 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость (3.18 mm) | V-0 | | UL 94 |
| Индекс кислорода | 30 | % | ASTM D2863 |
| Дополнительная информация | | | |

Recommended Storage Temperature: 5°C Life @ 5°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 24 months Life @ 21°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 5 days Life @ 35°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 2 days Spiral Flow, 177°C, 1000 psi: 97 cm Automatic Orifice Viscosity, 175°C, Shear Rate is 157000 sec⁻¹, 1 mm die length, 1/2 mm diameter: 13 to 21 Pascal sec Ram Follower Gel Time, 177°C: 20 sec Ash Content: 73 % Hydrolyzable Halides: <1 ppm Cull Hot Hardness, Shore D, 90 sec, 175°C: 80 Arc Resistance, 110v AC 180 sec All test specimens are transfer molded and post cured for 4 hours at 175°C
Linear Thermal Expansion, Alpha 1: 20 cm⁻⁶/cm/°C
Linear Thermal Expansion, Alpha 2: 65 cm⁻⁶/cm/°C

Инструкции по впрыску

Resin Transfer Molding:

Preheat Temperature: 88 to 99°C

Molding Temperature: 170 to 190°C

Molding Pressure: 750 to 1000 psi

Cure Time, 177°C: 1 to 2 min

Post Mold Cure Time, 175°C: 4 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat